

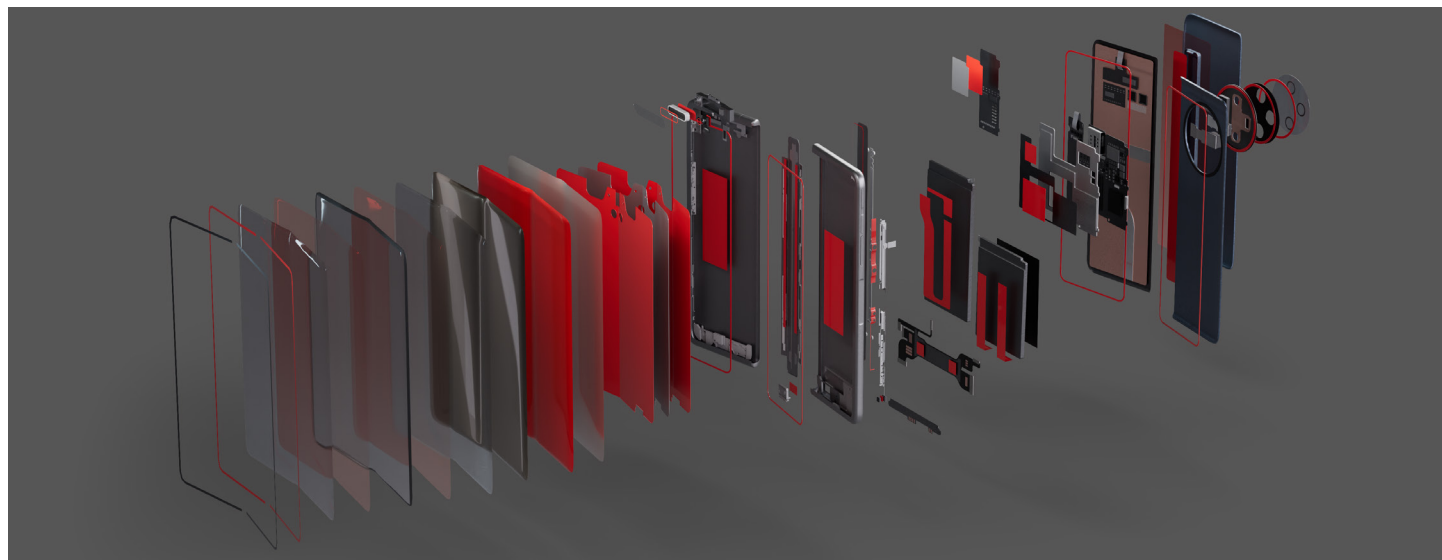
スリムで軽量な折りたたみデバイスを実現する 接着ソリューション



次世代デバイスの可能性を切り拓く

世界の主要なスマートフォンやエレクトロニクス機器の多くにおいて、テサの革新的な粘着テープソリューションが採用されています。当社の製品は、デバイス全体にわたるライフサイクルの各段階で発生する技術的課題に対し、確かな機能性と信頼性で応えます。

テサは、エレクトロニクス分野における豊富な実績、グローバルに展開するカスタマーソリューションセンター、そしてお客様との協働を重視した問題解決型のアプローチを通じて、次世代デバイス、特に折りたたみ式スマートフォンの実現に向けた取り組みを強力に支援しています。

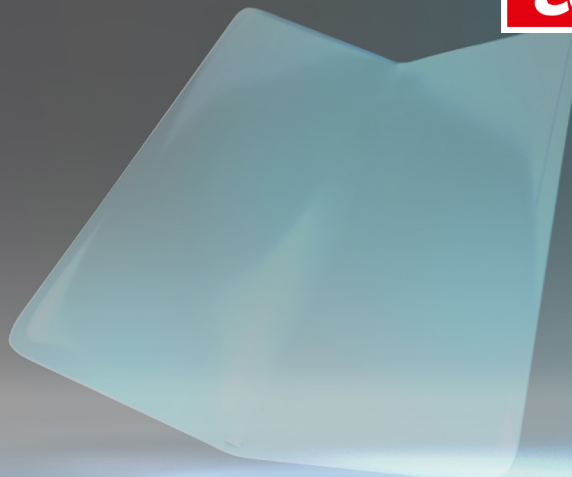


デバイス全体における当社のソリューション

折りたたみ式デバイスの製造における最初のコンセプトからコンポーネントのリワークまでのあらゆる側面において、最適なソリューションを提供いたします。

未来を創造する

折りたたみ式デバイスにおける信頼できるパートナーとして テサの粘着テープは、お客様が直面する複雑な技術的課題の解決をサポートし、次世代のスマートフォンの開発を支援します。



1. ディスプレイ底面の取り付け

折りたたみ式ディスプレイは、折りたたみ式デバイスの中で最も高価で壊れやすいコンポーネントの一つです。組み立てプロセス中にリワークが必要となることも少なくありません。これを容易にするために、当社は熱で剥がせるPEフォームテープからBond & Detachまで、さまざまなソリューションを提供しています。これらのソリューションは、メーカーが「修理する権利」に関する法律を遵守する上でも役立ちます。

2. アースおよびシールド

折りたたみ式デバイスがよりスリム化につれて、数十個もの内部コンポーネントが互いに近接して配置されるようになります。当社の導電性粘着テープは、EMIシールド、アース、高導電性、空隙埋めを実現し、すべてのコンポーネントの効率的な性能を実現します。

3. 熱対策

当社の熱対策用感圧接着剤は、従来の感圧接着剤とは異なり、熱を効果的に放散し、デバイスの温度を調節する能力に優れています。各ソリューションは、優れた熱伝導性と表面の濡れ広がり特性を持つように設計されており、特に熱要件が高まる折りたたみ式スマートフォンのスリムなデザインにおいて重要です。例えば、ペーパーチャンバーなどの主要コンポーネントの取り付けに最適なソリューションです。

4. ヒンジの取り付け

折りたたみ式スマートフォンのように、頻繁に折りたたまれるデバイスでは、ヒンジ部分が特に化学薬品にさらされやすくなります。当社の粘着テープは、粘着剤の浸透と、粘着剤とコンポーネントの間に発生する「界面クリープ」の両方からヒンジの取り付け部分を保護するシールを形成するように設計されています。

5. バッテリーの取り付け

設計スペースが限られている場合、当社の幅広いバッテリー取り付けソリューションを活用することで、より多くのことを実現することができます。信頼性の高い接着力と優れた耐衝撃性を兼ね備えた超薄型両面粘着テープや、バッテリーの取り外しが容易なBond & Detachが、お客様のニーズにお応えします。

6. ディスプレイのラミネート

当社のディスプレイ用ラミネーションテープは、用途を問わず信頼性の高いソリューションを提供します。クリーンルーム環境で製造された光学透明粘着剤は、優れた透明性を実現するとともに、連続的な折りたたみにも耐えるよう設計されています。これにより、お客様に対してより高い耐久性を持つデバイスを提供することが可能です。

7. 背面カバーの取り付け

当社のアクリルフォームテープは、過酷な衝撃からデバイスを保護するために、耐久性のある緩衝性と強力な接着力を提供します。独自の粘弾性特性により、衝撃制御に最適な材料となっており、これによりデバイスの防水性能が向上し、耐久性も高まります。



折りたたみ式デバイスに関するお客様の課題を共に解決するために、ぜひお気軽に当社にお問い合わせください。